

# 《科技入园模式与机制研究》

## 书籍信息

版次：31

页数：

字数：

印刷时间：

开本：B5

纸张：

包装：平装

是否套装：

国际标准书号ISBN：9787030390653



本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

[更多资源请访问www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)